YJX 雅晶鑫

Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

Customer	
Production Name	**SMD CRYSTAL SEAM 3.2*2.5**
Customer P/N	N/A
P/N	TAXM8M4RFDCET2T
Revision	A
Print Date	**2026-03-13**

Drawn	**Checked**	**Approved**
陳昭昭	鄭利	李虹

Pb

RoHS Compliant

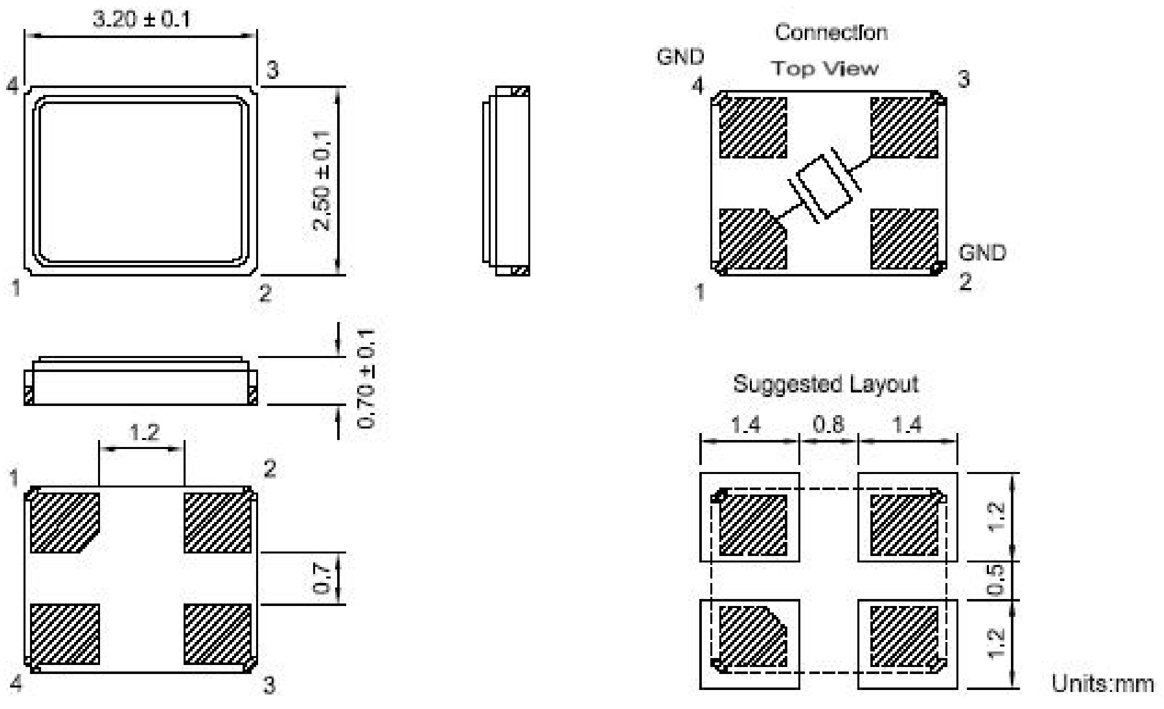
联络方式：电邮：lihong@taesz.cn http://www.taesz.cn 联络人：李先生

Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		SEAM 3.2*2.5		
2.Mode of Oscillation（振动模式）		Fundamental		
3. Frequency（标称频率）		8.000000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）		12		pF
5.Drive Level（激励功率）		≤100		uw
6.Equivalent Resistance（谐振电阻）		≤250		Ω
7.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）		5		pF Max
8.Motional Capacitance (C1) (动态电容)		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃（调整频差）		-20	20	ppm
10.Stability over operation temperance（温度频差）		± 20		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）		500MΩ Min @100V		MΩ
12.Operating Temperature Range（工作温度范围）		-40	85	℃
13. Storage Temperature Range（储存温度范围）		-55	125	℃
14. Aging（老化率）		± 3		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm）外形尺寸（单位：mm）

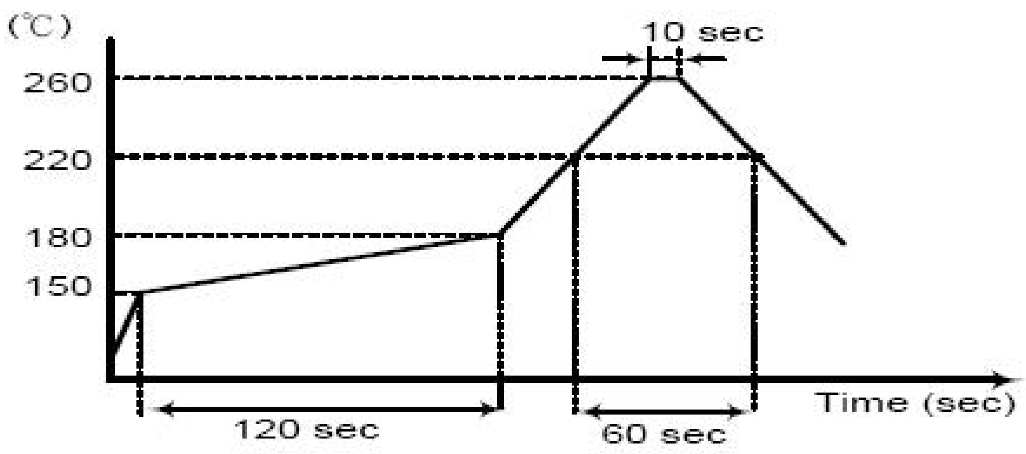


- **SUGGESTED REFLOW PROFILE** （回流焊曲线图）

Total time:200sec.Max. （总时间：200秒 最大）

Solder melting point:220℃（熔点220 ℃ ）

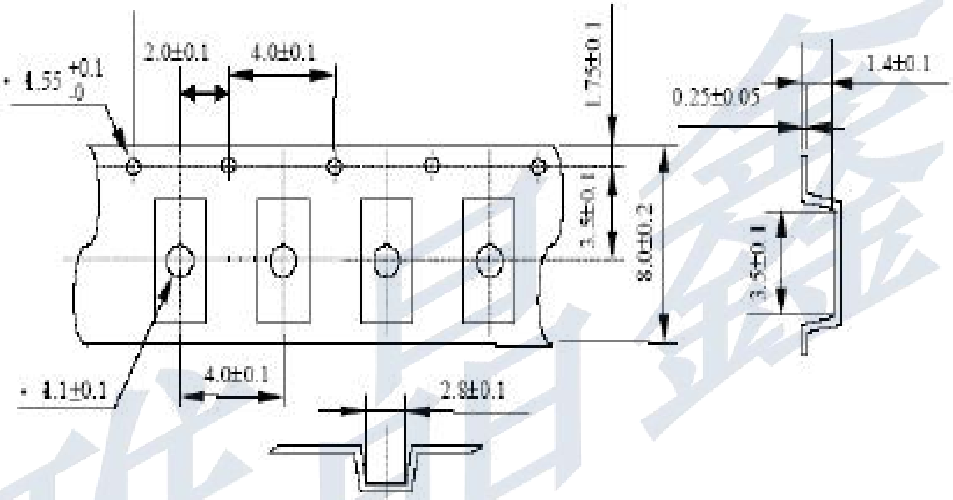
Profiles Feature（特性）		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)	平均升温速度	3℃/second Max
Preheat ■ Temperature Min (Ts min) ■ Temperature Max (Ts max) ■ Time (ts min to ts max)	预热 最低温度 最高温度 从最低到最高时间	 125℃ 200℃ (60～180) seconds
Time maintained above ■ Temperature(T1) ■ Time(tp)	维持上述时间 温度 时间	 217℃ (60～150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp)	最高点温度	260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp)	高温维持时间	(20～40) seconds
Ramp-down rate	降温速度	6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature	从25℃到最高温度的时间	8 minutes max
Suggest reflow times	建议 reflow次数	3 Times max



★ 备注：

1. 以上可靠性项目为我司常规测试项目，若客户对产品有跌落，冲击，碰撞以及涉及到超声波焊接工艺的需求，请将贵司的需求反馈给我司，我司会对该产品的可靠性项目进行更新。2.客户端在对晶体加热后，为了保证频率的准确性，建议将晶体充分冷却后再进行相关测试。3.产品符合环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。

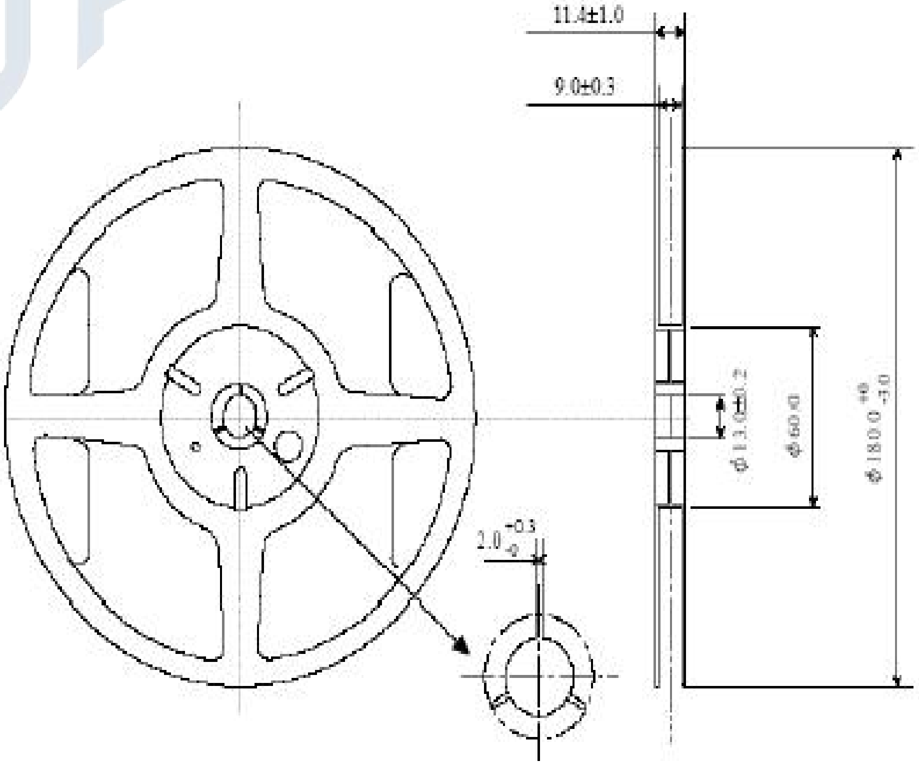
- **PACKING（包装） 3Kpcs/REEL**



[Size in mm]

8.3. Reel dimension & Outline drawing

Material of the Reel : PS



● RELIABILITY SPECIFICATIONS（信赖度试验）

No	Test Item（测试项目）	Test Conditions（测试条件）	eference（参考）	Spec.
1	High Temperature High Humidity Storage (高温、高湿、储存)	Temperature: 85℃±3℃ 温度: 85℃±3℃ Relative Humidity:85%RH 相对湿度: 85%RH Time: 96 Hours 时间: 96小时	JIS C5023	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
2	High Temperature Storage (高温储存)	Temperature: 125℃±3℃ 温度:125℃±3℃ Time: 96 Hours 时间:96 小时	MIL-STD-883E Method 1005.8	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
3	Low Temperature Storage (低温储存)	Temperature: -40℃±3℃ 温度：-40℃±3℃ Time: 96Hours 时间：96小时	MIL-STD-883E Method 1013	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
4	Thermal Shock (温度冲击)	Temperature1:-55℃±5℃ 温度1:-55℃±5℃ Temperature2:85℃±5 ℃ 温度2: 85℃±5 ℃ Temperature change between T1 and T2 5 min T1和T2温度在5分钟内改变 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone cycle 每次循环30分钟共10次	MIL-STD-202F Method 107 Condition A	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
5	RESISTANCE TO SOLDER HEAT (耐焊接热)	Solder Temperature: 260℃±5℃ 焊槽温度:260℃±5℃ Time: 10±1 Seconds 时间: 10±1秒	MIL-STD-202F Method 210E	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
6	Solderability(可焊性)	The solder pot temperature is 235±5°C , dwell time 5±0.5sec 245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒	J-STD-002B	Solder coat over at least 90% 上锡面积大于90%
7	Drop Test (落下试验)	3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board 从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上	JIS C6701	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
8	MECHANICAL SHOCK (机械冲击)	Half sine wave,1000 G duration:0.5ms 半正弦波,加速度1000G 持续时间：0.5s 3 Times for all 3 directions X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次	MIL-STD-202F Method 213B	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically
9	Vibration (机械振动)	Frequency Range: 10Hz～2000Hz 频率范围: 10Hz～2000Hz Amplitude: 0.75mm 振幅：0.75mm 2 Hours in each direction, total 6 Hours X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时	MIL-STD-883E Method 2007.3	Freq. ≤±5ppm △ESR≤±20% Good hermetically